

证券代码：688620 证券简称：安凯微

广州安凯微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-IR-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	国金证券、中信证券、华金证券、交银施罗德、浦银安盛、东方证券、国开证券、原点资产、诺安基金、宝盈基金、招商资管、善思投资、海通创新
时间	2025年05月27-29日
地点	深圳、上海
上市公司参会人员姓名	1、副总经理、董事会秘书 李瑾懿 2、证券事务部 葛淳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 投资者了解公司基本信息、主营业务、技术、产品、市场经营、发展战略等情况。</p> <p>二、 投资者提出的问题与公司的回复情况。</p> <p>Q1：公司物联网摄像机产品可以应用到哪些终端场景，与之匹配的产品与技术规划是什么？</p> <p>A1：物联网摄像机芯片是视觉 SoC 芯片，可以广泛应用于家用摄像机、安防摄像机、婴儿监视器、云台摄像机、AI 眼镜、工业视觉等典型和非典型摄像机场景。</p> <p>公司一直深耕 AIoT 视觉领域，对物联网摄像机产品线的规划注重像素与算力的双轨协同布局。像素方面，将覆盖从 100 万像素到 8K 超高清分辨率，其中 4K 分辨率芯片已成功量产并满足主流市场需求；</p>

	<p>8K 分辨率芯片在研发，为未来工业视觉、专业行业应用等对图像信号处理有更高或者特殊要求的场景奠定了技术基础。算力方面，已经推出的芯片具备 0.5TOPS-2TOPS 算力，并在研具有更高算力的芯片，以形成具有轻量级、较高算力和更高算力的芯片系列，满足端侧智能化处理需求。此外，公司不但在端侧匹配研发多种 AI 应用算法模型，也基于大视觉模型技术开发本地化、场景化中小模型，边端结合满足客户或用户对于智能视觉终端的差异化需求和要求。</p> <p>Q2：随着视觉应用场景的多元化，不同终端对算法的差异化需求明显。公司如何应对和满足这些需求？</p> <p>A2：公司内部有一支专门从事算法研发的团队，团队成员包括国家和地方认定的高层次人才，已自主开发多种轻量级 AI 算法参数模型，包括语音降噪、人车非识别、活体检测、哭声识别等算法，以与硬件结合，给客户产品双重赋能。</p> <p>Q3：公司对于智能眼镜芯片有规划吗？会否把支持智能眼镜核心需求的 IP 都集成到单芯片中？</p> <p>A3：今年上半年公司已推出一颗针对 AI 眼镜的低功耗智能视觉芯片 KM01W。该芯片内置 ISP、NPU、WiFi/BLE 等。且基于 KM01W 的系统开发平台已经发布。该芯片目前处于市场推广阶段。公司关注并看好智能眼镜的市场前景，有针对 AI 眼镜的持续的芯片产品规划。</p> <p>目前市面上的智能眼镜方案多样化，两颗或多颗主控搭配的实现方案并行。公司有丰富的自研 IP 积累，已经掌握了智能眼镜主控芯片的几个重要 IP，包括 ISP、NPU、BLE/蓝牙音频、显示等，低功耗技术已在各类 IoT 终端中持续演练和升级，SoC 架构相关技术也是多年积累的核心技术之一，我们有能力针对不同的 AI 眼镜产品终端需求把相关重要的 IP 技术（包括但不限于上述这些部分或全部 IP）集成到单颗 SoC 中，但具体需要基于各芯片产品定义决定。</p> <p>Q4：公司新推出的低功耗蓝牙芯片可以应用于什么产品？</p> <p>A4：公司的低功耗蓝牙音频芯片已经并可广泛应用于智能门锁、智能音箱、智能玩具、AI 耳机（TWS/OWS）、教育电子等。</p> <p>Q5：公司芯片是否可以用于家电产品？</p> <p>A5：可以的，且已经有部分产品在该领域应用。</p> <p>Q6：库存看起来有点高？</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	A6: 公司库存处于水平正常。截至 2024 年度报告期末，公司存货主要为公司芯片以及对应的晶圆和配套封装芯片，其中配套材料居多。公司根据在手订单、客户预计需求、上游晶圆制造和封装测试的产能以及公司的库存情况合理制定采购计划。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次交流活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。
日期	2025 年 05 月 29 日
会议记录人：葛淳 填表人：葛淳 填表日期：2025-05-29	